

(19)日本国特許庁(JP)

**(12)特許公報(B2)**

(11)特許番号  
**特許第7283407号**  
**(P7283407)**

(45)発行日 令和5年5月30日(2023.5.30)

(24)登録日 令和5年5月22日(2023.5.22)

(51)国際特許分類

H 0 5 K      1/18 (2006.01)  
G 0 1 C      19/5783(2012.01)

F I

H 0 5 K      1/18  
G 0 1 C      19/5783

F

請求項の数 4 (全12頁)

(21)出願番号	特願2020-17158(P2020-17158)	(73)特許権者	000004260
(22)出願日	令和2年2月4日(2020.2.4)		株式会社デンソー
(65)公開番号	特開2021-125523(P2021-125523)		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
	A)	(74)代理人	110001128
(43)公開日	令和3年8月30日(2021.8.30)		弁理士法人ゆうあい特許事務所
審査請求日	令和4年1月26日(2022.1.26)	(72)発明者	伊藤 啓太郎 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
		(72)発明者	明石 照久 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
		(72)発明者	寺澤 英己 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
		(72)発明者	宝地 卓

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電子装置

**(57)【特許請求の範囲】****【請求項1】**

被実装部材(10)にはんだ(30)を介して電子部品(20)が配置された電子装置であって、

一面(10a)を有する前記被実装部材と、

外形が直方体状とされ、前記被実装部材の一面と対向する面(202)の外縁部に複数の電極(22)が形成され、前記一面に配置される前記電子部品と、

前記電子部品の電極と前記被実装部材との間に配置され、前記電極と前記被実装部材とを電気的、機械的に接続する前記はんだと、

前記はんだの周囲に配置され、前記電子部品と前記被実装部材とを機械的に接続するサイドフィル(40)と、を備え、

前記電子部品は、一面(201)、前記一面と反対側であり、前記電極が形成される他面(202)、前記一面と前記他面との間を繋ぐ4つの側面(203)を有する前記直方体状とされ、慣性力を検出する慣性力センサを有しており、

前記電子部品の他面は、内縁部が前記はんだから露出しており、

前記サイドフィルは、前記はんだの少なくとも一部を被覆する状態で配置されると共に、前記電子部品における前記被実装部材側と反対側の角部(C1)が露出するように配置され、かつ前記側面のうちの前記他面側の部分にも配置されており、さらに、前記電子部品の側面に対する法線方向において、前記被実装部材の面方向に沿った方向を幅方向とすると、前記幅方向の両端部側に位置する部分が前記幅方向における内縁部側に位置する部

分より、前記被実装部材からの高さが低くなっている電子装置。

【請求項 2】

前記サイドフィルは、前記電子部品の中心に対して点対称、および前記電子部品の中心を通る仮想線に対して線対称の少なくとも一方の対称構成となるように配置されている請求項 1 に記載の電子装置。

【請求項 3】

前記サイドフィルは、前記被実装部材の一面に対する法線方向において、前記 4 つの側面と機械的に接続されるように配置されていると共に、それぞれの前記側面と接続される部分同士が離れている請求項 1 または 2 に記載の電子装置。

【請求項 4】

前記サイドフィルは、前記被実装部材の一面に対する法線方向において、前記 4 つの側面と機械的に接続されるように配置されていると共に、それぞれの前記側面と接続される部分同士が繋がっている請求項 1 または 2 に記載の電子装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子部品がはんだを介して被実装部材に配置された電子装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、電子部品がはんだを介して被実装部材に配置された電子装置が提案されている（例えば、特許文献 1 参照）。なお、被実装部材は、例えば、プリント基板等で構成される。電子部品は、裏面側に複数の電極を有する QFN 等で構成され、外形が直方体状とされている。そして、電子部品は、複数の電極がそれぞれはんだを介して被実装部材に接続されている。

【0003】

また、この電子装置では、はんだに印加される応力を低減してはんだの長寿命化を図れるように、はんだの周囲に、電子部品と被実装部材とを機械的に接続するサイドフィルが配置されている。より詳しくは、この電子装置のサイドフィルは、被実装部材の面方向に対する法線方向において、電子部品の角部を被覆するように配置されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【文献】特開 2013-102167 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記電子装置では、法線方向において、サイドフィルが電子部品の角部を被覆するように配置されている。この場合、電子部品における被実装部材側と反対側の角部までサイドフィルが配置されると、当該電子部品の角部にサイドフィルに起因して発生する応力が大きくなり易く、電子部品に発生するモーメントが大きくなり易い。このため、電子部品に不具合が発生する可能性がある。

【0006】

本発明は上記点に鑑み、電子部品の不具合が発生し難くなる電子装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するための請求項 1 では、被実装部材 (10) にはんだ (30) を介して電子部品 (20) が配置された電子装置であって、一面 (10a) を有する被実装部材と、外形が直方体状とされ、被実装部材の一面と対向する面 (202) の外縁部に複数の

10

20

30

40

50

電極(22)が形成され、一面上に配置される電子部品と、電子部品の電極と被実装部材との間に配置され、電極と被実装部材とを電気的、機械的に接続するはんだと、はんだの周囲に配置され、電子部品と被実装部材とを機械的に接続するサイドフィル(40)と、を備え、電子部品は、一面(201)、一面と反対側であり、電極が形成される他面(202)、一面と他面との間を繋ぐ4つの側面(203)を有する直方体状とされ、慣性力を検出する慣性力センサを有しており、電子部品の他面は、内縁部がはんだから露出しており、サイドフィルは、はんだの少なくとも一部を被覆する状態で配置されると共に、電子部品における被実装部材側と反対側の角部(C1)が露出するように配置され、側面のうちの他面側の部分にも配置されており、さらに、電子部品の側面に対する法線方向において、被実装部材の面方向に沿った方向を幅方向とすると、幅方向の両端部側に位置する部分が幅方向における内縁部側に位置する部分より、被実装部材からの高さが低くなっている。

#### 【0008】

これによれば、電子部品における被実装部材側と反対側の角部がサイドフィルで被覆されている場合と比較して、当該電子部品の角部にサイドフィルに起因して発生する応力が大きくなることを抑制でき、電子部品に発生するモーメントが大きくなることを抑制できる。このため、電子部品に不具合が発生することを抑制できる。

#### 【0009】

なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0010】

【図1】第1実施形態における電子装置の平面図である。

【図2】図1中の領域II部分の拡大図である。

【図3】図2中のIII - III線に沿った断面図である。

【図4】電子部品近傍を拡大した平面模式図である。

【図5】電子部品の側面に対する法線方向の模式図である。

【図6】サイドフィルの配置量とはんだに印加される最大引張応力との関係を示す図である。

【図7】サイドフィルの配置量と電子部品に印加される平均ミーゼス応力との関係を示す図である。

【図8A】第1実施形態の変形例における電子部品近傍を拡大した平面模式図である。

【図8B】第1実施形態の変形例における電子部品近傍を拡大した平面模式図である。

【図8C】第1実施形態の変形例における電子部品近傍を拡大した平面模式図である。

【図8D】第1実施形態の変形例における電子部品近傍を拡大した平面模式図である。

【図9A】第1実施形態の変形例における電子部品近傍の断面図である。

【図9B】第1実施形態の変形例における電子部品近傍の断面図である。

【図9C】第1実施形態の変形例における電子部品近傍の断面図である。

【図10】第2実施形態における電子部品近傍の平面模式図である。

#### 【発明を実施するための形態】

##### 【0011】

以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。

##### 【0012】

###### (第1実施形態)

第1実施形態の電子装置について、図面を参照しつつ説明する。なお、本実施形態では、GNSS(Global Navigation Satellite Systemの略)およびIMU( Inertial Measurement Unitの略)を備える自己位置推定システムを構成する電子装置について説明する。また、本実施形態の電子装置は、例えば、日本政府や米国運輸省道路交通安全局(NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration)が定義する自動化の

レベルにおいて、レベル3以上の運転支援装置が備えられる車両に搭載されると好適である。

#### 【0013】

電子装置は、図1～図3に示されるように、被実装部材としてのプリント基板10に電子部品20が配置された構成とされている。なお、図2では、理解をし易くするため、後述する絶縁膜15およびサイドフィル40を省略して示し、絶縁膜15に被覆される配線パターン11等も実線で示してある。また、図3では、電子部品20の断面構成を簡略化して示している。そして、以下では、プリント基板10における面方向の一方をx軸方向とし、面方向におけるx軸方向と直交する方向をy軸方向とし、x軸方向およびy軸方向と直交する方向をz軸方向として説明する。

10

#### 【0014】

本実施形態のプリント基板10は、一面10a側に配線パターン11および当該配線パターン11と接続されるランド11aが形成されると共に他面10b側に配線パターン12が形成され、内部に配線層13が形成された多層配線基板とされている。そして、一面10a側に形成された配線パターン11、他面10b側に形成された配線パターン12、内部に形成された配線層13は、貫通ビア14を介して適宜接続されている。なお、このようなプリント基板10は、例えば、ガラスエポキシ基板等を用いて構成される。

#### 【0015】

また、プリント基板10には、一面10a側に絶縁膜15が形成されていると共に、他面10b側に絶縁膜16が形成されている。なお、絶縁膜15、16は、それぞれソルダーレジスト等で構成される。そして、一面10a側に形成された絶縁膜15には、電子部品20と接続されるランド11aを露出させるコンタクトホール15aが形成されている。

20

#### 【0016】

なお、図2では、プリント基板10の面方向に対する法線方向（すなわち、z方向）において、電子部品20の周囲に形成される配線パターン11を省略して示している。但し、実際には、配線パターン11は、電子部品20が接続されるランド11aと接続されるように形成されている。

#### 【0017】

電子部品20は、本実施形態では、慣性力を検出する慣性力センサを備える構成とされている。具体的には、電子部品20は、x軸方向の加速度を検出する加速度センサ、y軸方向の加速度を検出する加速度センサ、z軸方向の加速度を検出する加速度センサを備えている。また、電子部品20は、本実施形態では、x軸方向周りの角速度を検出する角速度センサ、y軸方向周りの角速度を検出する角速度センサ、z軸方向周りの角速度を検出する角速度センサを備えている。つまり、本実施形態の電子部品20は、いわゆるIMUとされている。

30

#### 【0018】

そして、本実施形態の電子部品20は、具体的な構成については省略するが、QFNとされており、ケース21内に各加速度センサや各角速度センサが収容されて構成されている。ケース21は、外形が直方体状とされており、一面201、一面201と反対側の他面202、一面201と他面202との間を繋ぐ4つの側面203を有している。なお、ここでの直方体状とは、立方体状も含むものである。また、ここでの直方体状とは、一面201と隣合う2つの側面203との交点となる角部や、他面202と隣合う2つの側面203との交点となる角部等に微小さな湾曲部が形成されているものを含むものである。また、ケース21は、他面202を含む面に、ケース21に収容されている各加速度センサや各角速度センサと電気的に接続される複数の電極22が形成されている。本実施形態では、複数の電極22は、それぞれ各側面203から他面202に渡るように形成されている。

40

#### 【0019】

そして、電子部品20は、プリント基板10に形成されているランド11aと各電極22がはんだ30を介して電気的、機械的に接続されている。本実施形態では、電子部品2

50

0は、各側面203がx軸方向またはy軸方向と平行となるように配置されている。

#### 【0020】

また、はんだ30の周囲には、エポキシ系の樹脂で構成されるサイドフィル40がプリント基板10と電子部品20とを機械的に接続するように配置されている。つまり、電子部品20は、はんだ30およびサイドフィル40を介してプリント基板10に機械的に接続されている。

#### 【0021】

ここで、本実施形態におけるサイドフィル40について、図3～図5を参照しつつ具体的に説明する。なお、図5は、電子部品20の側面203の1つに対する法線方向から見た模式図であるが、プリント基板10を当該1つの側面203に対応する部分の断面図で示している。また、図5では、各電極22とランド11aとの間に配置されるはんだ30を省略して示している。

10

#### 【0022】

本実施形態では、サイドフィル40は、z方向において、電子部品20の各側面203と機械的に接続されるように4つ配置されていると共に、4つのサイドフィル40が互いに離れて配置されている。本実施形態では、電子部品20は、各側面203から他面202に渡ってそれぞれ6つの電極22が配置されており、各電極22と接続されるようにはんだ30がそれぞれ配置されている。以下では、側面203のプリント基板10における一面10aの面方向に沿った方向を幅方向とする。なお、幅方向とは、言い換えると、側面203における一面201または他面202との境界線に沿った方向ともいえ、図5中では紙面左右方向となる。そして、本実施形態のサイドフィル40は、幅方向における両端部の電極22と接続されるはんだ30を露出させると共に、幅方向における内縁部の電極22と接続されるはんだ30を被覆しつつ、当該はんだ30の間に位置する部分に配置されている。

20

#### 【0023】

また、サイドフィル40は、ケース21の側面203に対する法線方向において、幅方向に広がって配置されている。そして、サイドフィル40は、幅方向の両端部が内縁部側に位置する部分より、プリント基板10からの高さ（以下では、単に高さともいう）が低くなる山形状とされている。本実施形態では、サイドフィル40は、側面203に対する法線方向において、最も高さが高くなる部分と一端部との間の長さw1と、最も高さが高くなる部分と他端部との間の長さw2とが等しくされている。つまり、サイドフィル40は、幅方向の中心部に位置する部分の高さが最も高くされている。但し、サイドフィル40は、長さw1と長さw2とが異なっていてもよい。つまり、サイドフィル40は、幅方向の中心と異なる部分の高さが最も高くされていてもよい。

30

#### 【0024】

さらに、各サイドフィル40は、電子部品20の中心に対して点対称となるように配置されている。また、各サイドフィル40は、電子部品20の中心を通り、x軸方向に伸びる仮想線に対して線対称となると共に、y軸方向に伸びる仮想線に対して線対称となるように配置されている。

40

#### 【0025】

そして、サイドフィル40は、電子部品20のうちのプリント基板10側と反対側の角部（以下では、単に上端角部ともいう）C1が露出するように配置されている。本実施形態では、各側面203と接続されるサイドフィル40は、上記のように幅方向における両端部の電極22と接続されるはんだ30を露出させるように配置されており、電子部品20のうちのプリント基板10側の角部（以下では、単に下端角部ともいう）C2も露出するように配置されている。なお、上端角部C1とは、言い換えると、一面201と、隣合う2つの側面203との交点ともいえる。下端角部C2とは、言い換えると、他面202と、隣合う2つの側面203との交点ともいえる。

#### 【0026】

以上が本実施形態におけるサイドフィル40の構成である。

50

**【 0 0 2 7 】**

そして、プリント基板 10 には、図 1 および図 2 に示されるように、チップ抵抗やチップコンデンサ等の外付電子部品 51、マイコン 52、G N S S 用部品 53、他の回路部との接続を図るためのソケット 54 等が搭載されている。さらに、プリント基板 10 には、外縁部に、アルミ合金等で構成される筐体にプリント基板 10 をネジ固定するためのネジが挿通されるネジ孔 17 等が形成されている。

**【 0 0 2 8 】**

以上が本実施形態における電子装置の構成である。そして、このような電子装置は、例えば、プリント基板 10 に形成されたネジ孔 17 にネジが挿通されることで筐体にネジ固定され、金属性の蓋部が電子装置を収容するように筐体に備えられることで車載搭載部品を構成する。そして、この車載搭載部品は、筐体が機械的に固定されることで車両に搭載され、車両の各種制御を実行するのに用いられる。なお、電子装置は、筐体に固定される際や車載搭載部品を構成した後に当該車載搭載部品を車両に搭載する際、プリント基板 10 が反る可能性がある。つまり、本実施形態の電子装置は、反りが発生し得るプリント基板 10 上に電子部品 20 が配置されて構成されている。

10

**【 0 0 2 9 】**

以上説明した本実施形態によれば、プリント基板 10 と電子部品 20 とを機械的に接続するサイドフィル 40 が配置されているため、はんだ 30 の長寿命化を図ることができる。

**【 0 0 3 0 】**

そして、サイドフィル 40 は、電子部品 20 の上端角部 C1 を露出させるように配置されている。このため、電子部品 20 の上端角部 C1 がサイドフィル 40 で被覆されている場合と比較して、プリント基板 10 が反った場合等、電子部品 20 の上端角部 C1 に発生し得る応力が大きくなることを抑制でき、電子部品 20 に発生するモーメントが大きくなることを抑制できる。このため、電子部品に不具合が発生することを抑制できる。

20

**【 0 0 3 1 】**

特に、本実施形態では、電子部品 20 が I M U とされており、電子部品 20 に発生するモーメントが大きくなると、0 点変動や軸ずれ等の不具合が発生し易くなる。しかしながら、本実施形態では、サイドフィル 40 が上記のように配置されているため、0 点変動や軸ずれ等の不具合が発生することを抑制できる。つまり、本実施形態の電子装置によれば、電子部品 20 のロバスト性を向上でき、I M U の検出精度が低下することを抑制できる。そして、電子部品 20 に 0 点変動が発生し難いため、電子装置を組付けた後等に 0 点補正を行う必要がなくなり、調整コストや検査コストの削減を図ることもできる。

30

**【 0 0 3 2 】**

また、各サイドフィル 40 は、幅方向における端部の高さが内縁部の高さより低くされた山形状とされている。このため、例えば、サイドフィル 40 の高さが幅方向に沿って一定とされている場合と比較して、サイドフィル 40 の形状を厳密に制御する必要がなくなり、製造工程の簡略化を図ることができる。

**【 0 0 3 3 】**

さらに、サイドフィル 40 は、電子部品 20 の中心に対して点対称に配置されている。また、サイドフィル 40 は、電子部品 20 の中心を通り、x 軸方向に伸びる仮想線に対して線対称となると共に、y 軸方向に伸びる仮想線に対して線対称となるように配置されている。このため、各サイドフィル 40 から電子部品 20 に伝搬される応力を均一化し易くできる。つまり、サイドフィル 40 による応力のバランスを保ち易くなる。したがって、電子部品 20 に不具合が発生することをさらに抑制できる。

40

**【 0 0 3 4 】**

また、本実施形態の電子装置は、上記のように、電子部品 20 が I M U とされており、自己位置推定システムを構成するのに利用される。そして、電子部品 20 は、上記のように、軸方向がずれることが抑制されると共に、0 点変動が発生することが抑制されるため、6 軸の慣性力を高精度に検知できる状態となっている。このため、本実施形態の電子装置では、長時間に渡る車両のデッドレコニング（すなわち、慣性航法）を実現できる。

50

**【 0 0 3 5 】**

ここで、上記のようにサイドフィル40を配置することにより、はんだ30の長寿命化を図ることができる。しかしながら、サイドフィル40を配置することにより、プリント基板10と電子部品20とが機械的に接続される部分が増加するため、例えば、プリント基板10が反った場合等には、プリント基板10から電子部品20に伝搬される応力が増加する。

**【 0 0 3 6 】**

具体的には、図6に示されるように、サイドフィル40の配置量が多くなるほど、サイドフィル40に分散される応力が大きくなるため、はんだ30に印加される最大引張応力が小さくなる。このため、サイドフィル40の配置量を多くするほど、はんだ30の長寿命化を図ることができる。なお、ここでのサイドフィル40の配置量とは、プリント基板10と電子部品20とを機械的に接続する部分の量である。そして、サイドフィル40の配置量を多くすることは、プリント基板10と電子部品20とを機械的に接続する部分を多くすることである。

10

**【 0 0 3 7 】**

一方、図7に示されるように、サイドフィル40の配置量が多くなるほど、プリント基板10からサイドフィル40を介して電子部品20に応力が伝搬され易くなるため、電子部品20に印加される平均ミーゼス応力は大きくなる。したがって、サイドフィル40は、上記の構成としつつ、用途に応じて配置量が設定されることが好ましい。

**【 0 0 3 8 】**

20

## (第1実施形態の変形例)

上記第1実施形態において、サイドフィル40の形状は適宜変更可能である。例えば、各サイドフィル40は、図8A～図8Cに示されるように、プリント基板10に対する法線方向において、幅方向における両端部の2つの電極22と接続されるはんだ30を露出させつつ、幅方向における内縁部の2つの電極22と接続されるはんだ30を被覆するように配置されていてもよい。この場合、図8A～図8Cに示されるように、サイドフィル40の幅方向における長さは、適宜変更可能である。また、特に図示しないが、電子部品20の電極22の一部は、ケース21内に収容される慣性力センサと電気的に接続されない場合もある。この場合、サイドフィル40は、慣性力センサと電気的に接続されない電極22と接続されるはんだ30を露出させるように配置されていてもよい。つまり、サイドフィル40は、仮にはんだ30が破壊されたとしても、電子部品20とプリント基板10との電気的な接続に影響がないはんだ30を露出させるように配置されていてもよい。さらに、図8Dに示されるように、各サイドフィル40は、各電極22と接続されるはんだ30を全て被覆するように配置されていてもよい。

30

**【 0 0 3 9 】**

さらに、各サイドフィル40における最も高い部分の高さは、適宜変更可能である。例えば、図9Aに示されるように、サイドフィル40は、高さが一面201に達するように形成されていてもよい。また、図9Bに示されるように、サイドフィル40は、はんだ30とほぼ同じ高さとされていてもよい。さらに、図9Cに示されるように、サイドフィル40の外面は、直線状ではなく、曲面状とされていてもよい。なお、図9A～図9Cは、図2中のIII-III断面に相当する断面図である。

40

**【 0 0 4 0 】**

## (第2実施形態)

第2実施形態について説明する。本実施形態は、第1実施形態に対し、サイドフィル40の形状を変更したものである。その他に関しては、第1実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。

**【 0 0 4 1 】**

本実施形態では、図10に示されるように、サイドフィル40は、ケース21の側面203に配置された部分同士が繋がって配置されている。但し、ケース21の側面203に配置されたサイドフィル40同士は、電子部品20の下端角部C2近傍で繋がっており、

50

上端角部 C 1 は露出した状態となっている。なお、本実施形態では、電子部品 2 0 の下端角部 C 2 は、サイドフィル 4 0 で被覆されていてもよいし、サイドフィル 4 0 から露出していてもよい。

#### 【 0 0 4 2 】

以上説明した本実施形態によれば、サイドフィル 4 0 は、ケース 2 1 の側面 2 0 3 に配置された部分同士が繋がっている。このため、ケース 2 1 の側面 2 0 3 に配置されたサイドフィル 4 0 が互いに繋がらないようにするための詳細な制御が不要となり、製造工程の簡略化を図ることができる。

#### 【 0 0 4 3 】

(他の実施形態)

本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲内において適宜変更が可能である。

#### 【 0 0 4 4 】

例えば、上記各実施形態において、被実装部材としてのプリント基板 1 0 は、ガラスエポキシ基板ではなく、セラミックス基板等で構成されていてもよい。

#### 【 0 0 4 5 】

また、上記各実施形態において、電子部品 2 0 は、3つの加速度センサと3つの角速度センサを備えていてもよい。例えば、電子部品 2 0 は、2つ以下の加速度センサを有する構成とされていてもよいし、2つ以下の角速度センサを有する構成とされていてもよい。また、電子部品 2 0 は、加速度センサのみで構成されていてもよいし、角速度センサのみで構成されていてもよい。さらに、電子部品 2 0 は、加速度や角速度と異なる物理量を検出する物理量センサを有する構成とされていてもよい。この場合、電子部品 2 0 は、この物理量センサのみを有する構成とされていてもよいし、この物理量センサと、加速度センサおよび角速度センサの少なくとも一方を有する構成とされていてもよい。さらに、電子部品 2 0 は、加速度や角速度を含む物理量を検出するセンサを備えず、コンデンサや抵抗等が配置された構成とされていてもよい。

#### 【 0 0 4 6 】

さらに、上記各実施形態において、電子部品 2 0 は、他面 2 0 2 を含む面に電極 2 2 が配置されるのであれば、QFN とされていてもよい。例えば、電子部品 2 0 は、SOP (Small Outline Non-leaded package の略)、VSON (Very-thin Small Outline Non-leaded package の略)、TQFN (Thin-Quad Flat No-Lead Plastic package の略)、LCC (Leaded Chip Carrier の略)、CLCC (ceramic leaded chip carrier の略)、DFN (Dual Flat package の略)、QFI (Quad Flat I-leaded package の略)、BGA (Ball Grid Array の略)、EBGA (Enhanced BGA の略)、FTBGA (Flex Tape BGA の略)、TFBGA (Thin & Fine-Pitch Ball Grid Array の略) 等とされていてもよい。

#### 【 0 0 4 7 】

そして、上記各実施形態において、サイドフィル 4 0 は、点対称および線対称の一方の対称構成となるように配置されていてもよい。なお、サイドフィル 4 0 が線対称に配置される場合には、x 軸方向に伸びる仮想線およびy 軸方向に伸びる仮想線の一方に対して線対称となるように配置されていてもよい。さらに、サイドフィル 4 0 は、点対称および線対称となるように配置されていてもよい。

#### 【 0 0 4 8 】

また、上記各実施形態において、プリント基板 1 0 と電子部品 2 0 の他面 2 0 2との間にアンダーフィルが配置されていてもよい。

#### 【 符号の説明 】

#### 【 0 0 4 9 】

- 1 0 プリント基板 (被実装部材)
- 2 0 電子部品
- 3 0 はんだ

10

20

30

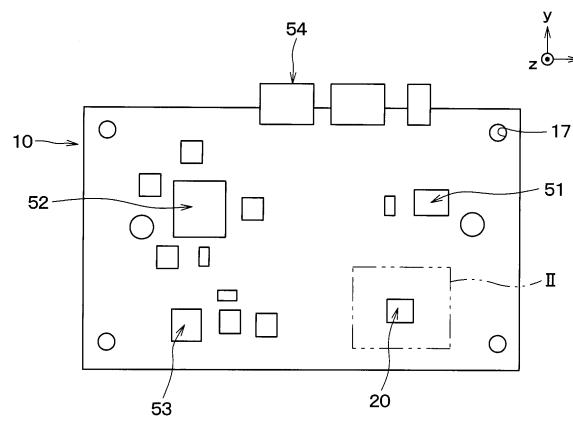
40

50

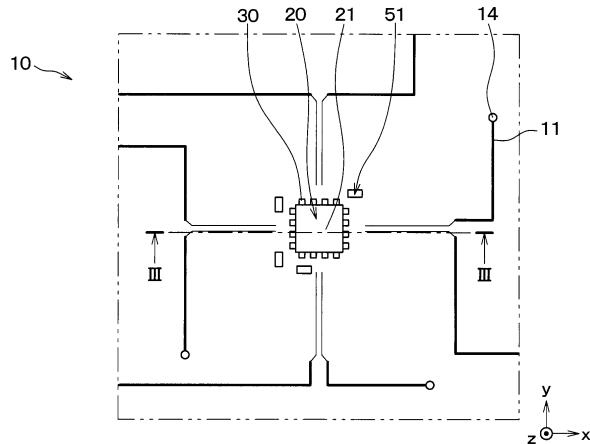
4 0 サイドフィル  
2 0 2 他面  
C 1 角部

【図面】

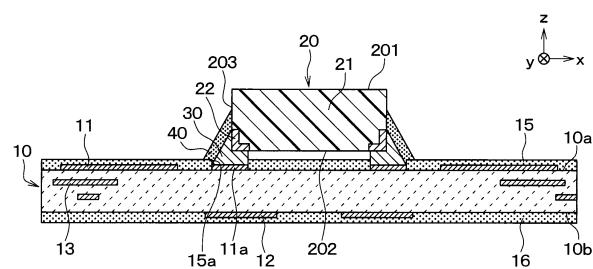
【図 1】



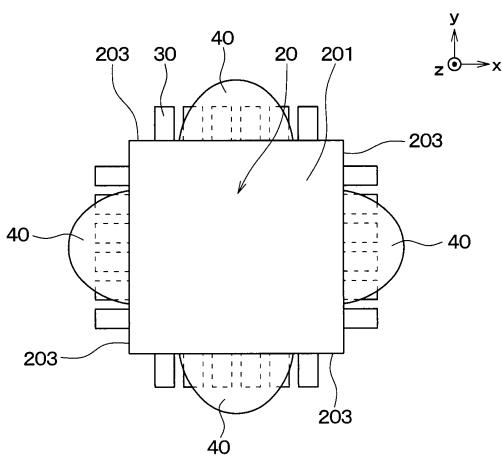
【図 2】



【図 3】



【図 4】



10

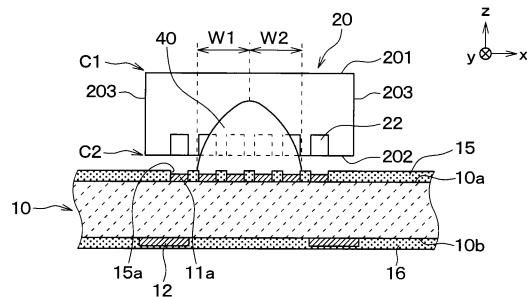
20

30

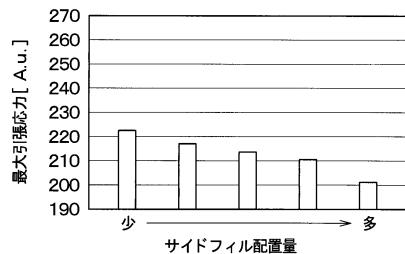
40

50

【図 5】

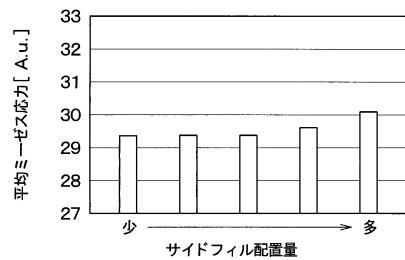


【図 6】

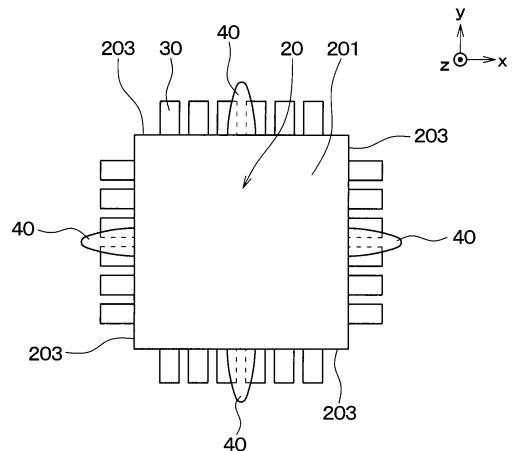


10

【図 7】

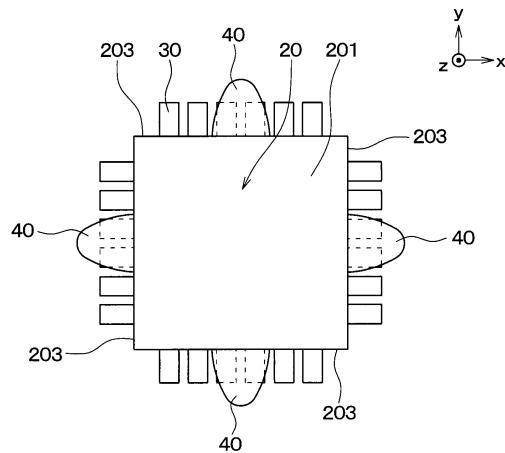


【図 8 A】



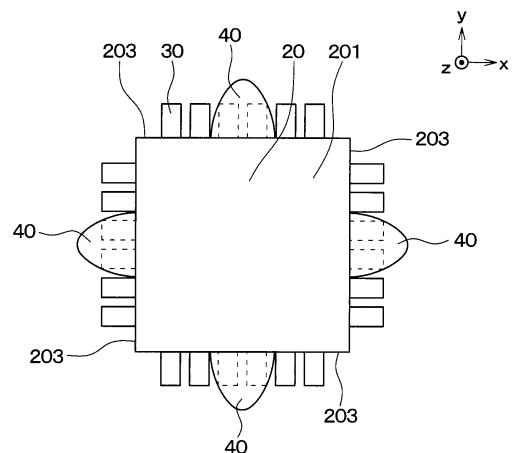
20

【図 8 B】



30

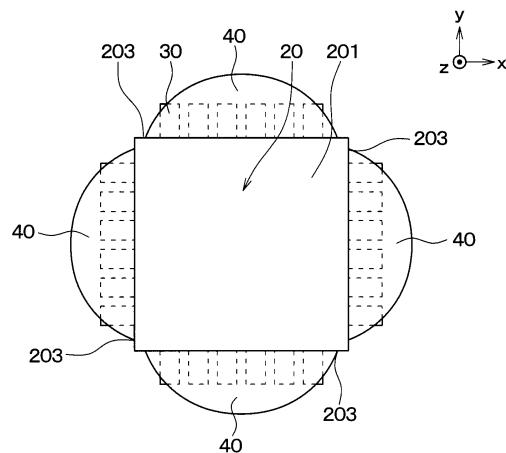
【図 8 C】



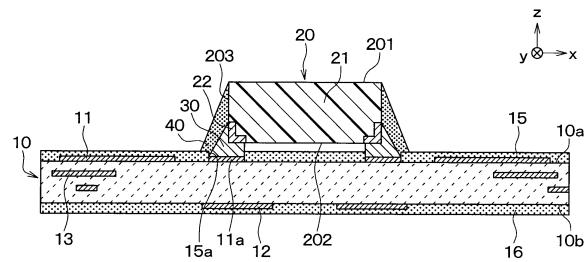
40

50

【図 8 D】

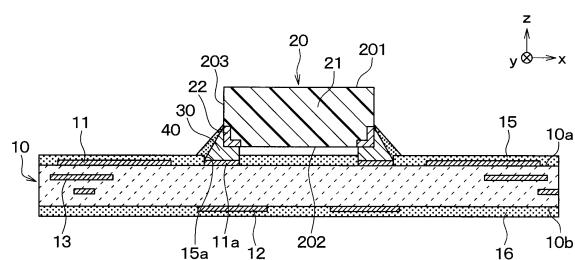


【図 9 A】



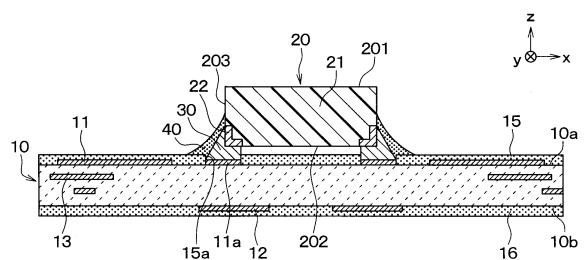
10

【図 9 B】



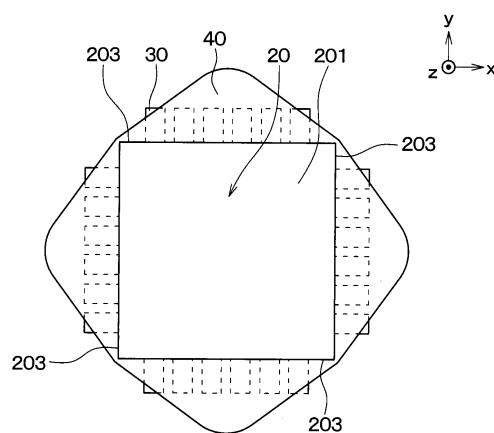
20

【図 9 C】



30

【図 10】



40

50

---

フロントページの続き

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

(72)発明者 吉田 直記

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

審査官 齊藤 健一

(56)参考文献 特表2016-530723(JP,A)

特開2001-308145(JP,A)

特開2010-283085(JP,A)

米国特許出願公開第2010/0077080(US,A1)

国際公開第2010/122757(WO,A1)

特表2005-502187(JP,A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

G01C 19/5783

H01L 23/28 23/31

H05K 1/00 3/46